

MICTOR

Interne TE-Nummer 1-1658071-4

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 112 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold Flash, Surface Mount, Power & Signal

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen

PCB-Steckverbindermontagetyp: **Buchse für die Leiterplattenmontage**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **112**Raster: **.8 mm [.031 in]****Eigenschaften****Produktmerkmale**

PCB-Steckverbindermontagetyp	Buchse für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Nein
Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	112
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	675 VAC
Isolierwiderstand	2 MΩ
Impedanz	100 Ω
Arbeitsspannung	125 VAC

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Schwarz
----------------------	---------

Kontaktmerkmale

Flachkontaktbreite	.38 mm[.015 in]
Flachkontaktdicke	.2 mm[.008 in]
Kontaktform	Einzelstrahl
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Blattvergoldet
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Blattvergoldet
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	1.27 µm[50 µin]
Kontakttyp	Stecksockel
Kontakt-nennstrom (max.)	1.25 A, 9.5 A

Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.15 mm[.006 in]
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	1.77 mm[.07 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage

Montage und Anslusstechnik

Montageausrichtungstyp für Leiterplatte	Fixierstifte
Gegensteckarretierung	Mit
Gegensteckführung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	.8 mm[.031 in]
Gehäusematerial	LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	3.05 mm[.12 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	.06 mm[1.27 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Satzverarbeitungsfunktion	Keine
---------------------------	-------

Stromkreis Anwendung

Strom und Signale

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse

UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge

22

Verpackungs-Typ

Einsatz, Kasten

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien
oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023
(233)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN
2023 (233)
Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I <
900 ppm im homogen Material. Außerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

[MSB0.80RC-ASY112DP,-,F,VCTY](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1658071-4_M.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1658071-4_M.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1658071-4_M.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

1-1658071-4

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 112 Position, .8 mm [.031 in]
Centerline, Fully Shrouded, Gold Flash, Surface Mount, Power & Signal



[Produktspezifikationen](#)

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch